

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/21/2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę:

części elektronicznych
dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów
PIAP
Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

CPV: 31711000-3

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 200 000 euro.

Miejsce dostawy:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Adres strony internetowej: www.piap.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH**

1. Nazwa i adres zamawiającego

**Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
Warszawa**

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) – dalej zwaną „ustawą”

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i wolnych od wad, niżej wymienionych części elektronicznych o parametrach szczegółowo wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Ilość części – 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I

<i>Część nr 1</i>	<i>Opis</i>		
	Oznaczenie producenta	Producent	Ilość
	C0603C822K5RACTU	KEMET	20
	43045-0412	Molex	30
	M50-3600542	Harwin	15

1-1634009-0	TE CONNECTIVITY / GREENPAR	30
BAT165	Infineon	230
SPP07N60C3	Infineon	15
SPP20N60C3	Infineon	10
L6562D	STMICROELECTRONICS	10
BC817-40	NXP	250
BCX51	NXP	40
BFR93A	NXP	25
IRF6648TR1	INTERNATIONAL RECTIFIER	30
BZV55-C12	NXP	75
BZV55-C4V7	NXP	55
M50-3100545	Harwin	80
LR2010-R10FW	WELWYN	35
LR2512-R05FW	WELWYN	20
SN65HVD231D	TEXAS INSTRUMENTS	75
53261-0271	Molex	35
TPSA226K006R0900	AVX	85
50YXF1000MEFC16X25	RUBYCON	5
CRCW0603174KFKEA	vishay	20
TSM 0512S	TRACOPOWER	5
SN65HVD251D	TEXAS INSTRUMENTS	50
BC807-25	FAIRCHILD	130
UC2825DW	TEXAS INSTRUMENTS	8
CC1020-RTB1	TEXAS INSTRUMENTS	25
MJ-064	PRO SIGNAL	16
USBLC6-2SC6	STMICROELECTRONICS	25
LT3724EFE#PBF	LINEAR TECHNOLOGY	17
SG-310 SCF C 8.0MHZ	EPSON TOYOCOM	75
0907-4-15-20-75-14-11-0	Mill MAX	35
C0805C106K4PAC	KEMET	20
IRF7425PBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	110
SK26A	TAIWAN SEMICONDUCTOR	300
SK36B	TAIWAN SEMICONDUCTOR	250
06035C104K4T2A	AVX	3000
24AA08T-I/OT	Microchip	70
C1210C475K5RACTU	KEMET	100
AT24C04BN-SH-B	Atmel	100
LM3404HVMR	NATIONAL SEMICONDUCTOR	85

IRFR5305TRL PBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	35
SG73P1JT TD1603F	KOA	20
IRF6644TR1 PBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	7
MCP9800A0T-M/OT	Microchip	40
M80-8420242	Harwin	10
IRLR2705PBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	10
C1206C106K4RAC-TU	KEMET	550
CRCW06033K00FKEA	vishay	50
CRCW060339K0FKEA	vishay	50
CRCW080512K4FKEA	vishay	50
CRCW1206100RFKEA	vishay	50
XTR106UA	TEXAS INSTRUMENTS	5
FDC5614P	FAIRCHILD	60
SN74LVC1G123DCUT	TEXAS INSTRUMENTS	10
PMEG6010CEH	NXP	130
2N7002	NXP	150
LQH31CN101K03L	MURATA	10
P20-0245R	Harwin	35
UC2842N	TEXAS INSTRUMENTS	25
C5S-20.000-12-3030-X	AKER	10
IHLP4040DZER470M11	vishay	20
OPA2277UA	TEXAS INSTRUMENTS	80
M74VHC1G132DTT1G	ON SEMICONDUCTOR	10
C1206C475K5PACTU	KEMET	750
MCHP03W8F1504T5E	Multicomp	50
ERJT08J102V	Panasonic	20
ERA3AEB473V	Panasonic	10
ERA3AEB154V	Panasonic	20
ERA6AEB104V	Panasonic	60
STM32F103C8T6	STMICROELECTRONICS	45
STM32F103T8U6	STMICROELECTRONICS	20
BZX84C5V1	vishay	35
TZMC18-GS08	vishay	10
BZT55C3V3	Multicomp	20
STM32F103VET6	STMICROELECTRONICS	20
MUR460	Multicomp	10
742792510	WUERTH ELEKTRONIK	100
B82477P4154M000	EPCOS	10
AD8603AUJZ	Analog Devices	10
A1391SEHLT-T	Allegro MicroSystems	750

SF-1206S050-2	BOURNS	50
SF-1206S100-2	BOURNS	10
SF-1206S300-2	BOURNS	200
RR0816P-103-B-T5	SUSUMU	70
RR0816P-104-B-T5	SUSUMU	20
TLJB227M006R0500	AVX	20
TPSD107K020R0150	AVX	15
LT1117CST-3.3	LINEAR TECHNOLOGY	10
LT1963AEST-1.8#PBF	LINEAR TECHNOLOGY	10
ERA3AEB202V	Panasonic	10
ERA6AEB242V	Panasonic	30
ERA6AEB303V	Panasonic	30
IRFS3006-7PPBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	65
RR0816P-682-B-T5	SUSUMU	25
SMBJ28A-E3/52	vishay	10
SMBJ33A-E3/52	vishay	30
DRV8402DKD	TEXAS INSTRUMENTS	25
ERJ8BSFR10V	Panasonic	10
DF3A-12P-2DS	Hirose	20
12061C104KAZ2A	AVX	30
IHLP2525AHER4R7M01	vishay	130
AS193-73LF	SKYWORKS SOLUTIONS	40
TR3B107K6R3C0500	vishay	650
LM3429MH	NATIONAL SEMICONDUCTOR	20
T491D227K016ZT	KEMET	50
SMBJ12A-E3/52	vishay	100
SMBJ15A-E3/52	vishay	50
SS10P6-M3/86A	vishay	20
08055C474K4T2A	AVX	150
LT3991EDD#PBF	LINEAR TECHNOLOGY	90
LT3991EMSE#PBF	LINEAR TECHNOLOGY	10
ADR3430ARJZ	Analog Devices	50
TPS76333DBVT	TEXAS INSTRUMENTS	15
IR2127SPBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	35
IR2184S	INTERNATIONAL RECTIFIER	35
IRF530NPBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	30
IRFL110PBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	20
10MQ100NTR	vishay	60

IRF7343PBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	30
IRF5305SPBF	INTERNATIONAL RECTIFIER	20
RC1206JR-0710RL	Yageo	50
TC164-JR-0733RL	Yageo	100
MC 0.125W 1206 1% 300K	Multicomp	50
CBC3225T470MR	TAIYO YUDEN	20
MBR20200CTG	ON SEMICONDUCTOR	20
SN74HC00D	TEXAS INSTRUMENTS	10
TL431AID	TEXAS INSTRUMENTS	20
TL7705AID	TEXAS INSTRUMENTS	50
ECA2WHG100	Panasonic	10
43045-1212	Molex	10
43045-1200	Molex	10
53047-0410	Molex	10
TS921ID	STMICROELECTRONICS	10
BAR43S	STMICROELECTRONICS	180
FDC6330L	FAIRCHILD	100
STPS3L60U	FAIRCHILD	10
FX2-D3227	TE CONNECTIVITY	25
1-1337584-0	TE CONNECTIVITY / GREENPAR	100
MR-28406	KNOWLES ACOUSTICS	12
EV200AAANA	TE CONNECTIVITY	4
1-1478923-0	TE CONNECTIVITY / GREENPAR	10
51021-0300	Molex	20
51021-0400	Molex	20
M80-8980205	Harwin	30
M80-8880605	Harwin	65
M80-8820342	Harwin	110
M80-8511442	Harwin	30
M80-8531442	Harwin	5
M80-8530442	Harwin	75
M80-8530642	Harwin	50
M80-8530842	Harwin	20
AD7416ARZ	Analog Devices	60
AD8130ARZ	Analog Devices	10
AD8174ARZ	Analog Devices	20
AD8542ARZ	Analog Devices	10
ADM3202ARNZ	Analog Devices	30
ADM3485EARZ	Analog Devices	20

ADP3334ARZ	Analog Devices	15
ADXL330KCPZ	Analog Devices	15
SSM2211S	Analog Devices	30
RL0805FR-7W0R1L	Yageo	10
CRL1206-JW-R300ELF	BOURNS	100
M80-8980305	Harwin	80
BSS138PW	NXP	250
NF2D-B-2	Neutrik	15
NF2D-B-4	Neutrik	15
NF2D-B-9	Neutrik	15
AC03000006809JAC00	vishay	10
EEEFK1A102P	Panasonic	40
SMBJ24A-E3/52	vishay	50
EEEF1H470AP	Panasonic	90
T491D476K025AT	KEMET	30
C0603C150J5GAC	KEMET	40
C0603C332J5GAC 7867	KEMET	150
BD075-03-A-1-L-D	GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY	20
223 858 615 611	Yageo	50
MMBD4148SE	FAIRCHILD	140
FDC5612	FAIRCHILD	60
FIN1002M5X	FAIRCHILD	15
LM4549BVH/NOPB	NATIONAL SEMICONDUCTOR	20
LM2672M-ADJ	NATIONAL SEMICONDUCTOR	85
LM5005MH	NATIONAL SEMICONDUCTOR	25
LM5010AMH	NATIONAL SEMICONDUCTOR	55
MCCA000581	Multicomp	230
GRM3195C1H223JA01D	MURATA	50
EEEFK1H221P	Panasonic	75
EEE1HA4R7SR	Panasonic	100
EEEFK1V101P	Panasonic	50
EEEFK1C471P	Panasonic	20
430450212	Molex	30
DS92LV1224TMSA/NOPB	NATIONAL SEMICONDUCTOR	10
LTC6802IG-1#PBF	LINEAR TECHNOLOGY	30
SMBJ18A-E3/52	vishay	20
TDA1308T/N2	NXP	10
53398-0271	Molex	40
53398-0471	Molex	10

	HFW1201K45	TE Conectivity	20
	M80-8820242	Harwin	50
	M80-8880405	Harwin	30
	M80-8881405	Harwin	25
	M80-8420342	Harwin	45
	M80-8510642	Harwin	35
	M80-8511042	Harwin	10
	ERA6AEB103V	Panasonic	180
	SR10-0.010-1%	Caddock	10
	TAJA475K006RNJ	AVX	10
	T495D226K035ATE300	KEMET	10
	T491A105K016AT	KEMET	30
	T491B106K020AT	KEMET	150
	T491C106K035AT	KEMET	65
	TRJC107K010RRJ	AVX	70
	T491C107K016ZT	KEMET	80
	TRJB226K016RRJ	AVX	70
	TR3C226K025C0400	vishay	80
	T491A225K016AT	KEMET	20
	T491D337K006AT	KEMET	35
	T491C476K016AT	KEMET	30
	T491B106K016AT	KEMET	450
	36502AR10JTDG	TE CONNECTIVITY	100
	36502A18NJTDG	TE CONNECTIVITY	100
	XREWHT-L1-0000-00C01	CREE	20
	BZV55-C6V2	NXP	300
	GRM31CR71H225KA88L	MURATA	50
	SMBJ5.0A-E3/52	vishay	250
	Raspberry Pi Model B	<i>Raspberry Pi Foundation</i>	1
	43020-0400	MOLEX	25
	43020-0600	MOLEX	50
	43020-0800	MOLEX	25
	50079-8000	MOLEX	1000

Część II

Część nr2	Opis		
	Oznaczenie producenta	Producent	Ilość
	09185106324	HARTING	10
	MOR 1W-S 560K	ROYAL OHM	10

20.00M SMDHC49S	YIC	40
L78M05CDT	STMICROELECTRONICS	10
ACS712ELCTR-05B-T	Allegro MicroSystems	50
7-215079-6	TE CONNECTIVITY	55
7-215079-8	TE CONNECTIVITY	15
7-215460-8	TE CONNECTIVITY	10
8-0215079-2	TE CONNECTIVITY	10
154000.0,25	Siba	20
0679-9100-01	BEL FUSE	20
158000.0,25	Siba	200
158000.0,5	Siba	150
158000.1	Siba	120
158000.2	Siba	60
158000.3	Siba	60
158000.4	Siba	10
158000.7	Siba	120
BYV27/600	vishay	35
C1206C104K5RAC	KEMET	100
CL321611T-4R7K-N	Yageo	40
CY2P 680P		50
DC-7G3HWA	KINGBRIGHT ELECTRONIC	35
FKS2G013301A00KSSD	WIMA	10
G2R-1-E-12VDC	OMRON	20
HE2W107M22040HA	SAMWHA	20
HP06 1E 1%	ROYAL OHM	100
IRF7343	INTERNATIONAL RECTIFIER	10
KBL06	DC COMPONENTS	10
LCBB-601	FERROCORE	150
LE33CD	STMICROELECTRONICS	35
LL-304GD2Y	LUCKY LIGHT	100
LL-304ID2Y	LUCKY LIGHT	25
LM19CIZ/NOPB	NATIONAL SEMICONDUCTOR	15
LM211D	TEXAS INSTRUMENTS	20
LM2931CM/NOPB	NATIONAL SEMICONDUCTOR	10

LM3940IS-3.3/NOPB	NATIONAL SEMICONDUCTOR	10
LM78L05ACM/NOPB	NATIONAL SEMICONDUCTOR	15
112C-TXAR-R01	ATTEND	10
MCP25020-I/SL	Microchip	10
MCP4822-E/SN	Microchip	25
MCX6251B1-3GT30G-50	Amphenol	75
MKP1J032206A00MYSD	WIMA	10
MPEM-1U/400	SR PASSIVES	25
53047-0410	Molex	25
53261-0371	Molex	10
53261-0490	Molex	25
53261-0590	Molex	35
53261-0690	Molex	10
0532610771	Molex	10
53261-1271	Molex	35
53398-0590	Molex	20
SSM2166SZ	Analog Devices	20
TEST-1BU		400
TS53YJ5K	vishay	20
TS53YL1K	vishay	15
WL1H477M12020BB	SAMWHA	125
ZL231-26PG	NINIGI	10
ZL304-2X5P	NINIGI	20
ZL311-40P	NINIGI	3
430450200	Molex	70
430450600	Molex	30
32.768kHz WATCH-3x8	IQD	10
9-215083-2	TE CONNECTIVITY	30
B1112A1-ND3G-1-50	Amphenol	10
C330C224K1R5TA	KEMET	100
CNY17-3	vishay	35
DS26C32ATM/NOPB	NATIONAL SEMICONDUCTOR	35
9019010000	WEIDMULLER	50
9019040000	WEIDMULLER	300
9019100000	WEIDMULLER	100
9019130000	WEIDMULLER	50

9019190000	WEIDMULLER	
LL-S172VC-V1-2B	LUCKY LIGHT	25
LL-S172PGC-G51B	LUCKY LIGHT	80
KP-2012SYC	KINGBRIGHT ELECTRONIC	20
MCX1121A1-3GT30G-14-50	Amphenol	30
MCX6121A13-GT30G-5-50	Amphenol	50
MCX6251B1-3GT30G-50	Amphenol	150
43025-0200	Molex	50
43025-0200	Molex	30
43025-0400	Molex	30
43025-0600	Molex	30
43025-1000	Molex	10
0430450400	Molex	40
0430450800	Molex	25
51021-0200	Molex	50
51021-0300	Molex	20
51021-0400	Molex	10
51021-0500	Molex	10
51021-0700	Molex	25
0022012025	Molex	10
P6SMBJ43A	SEMIKRON	200
PC357NT	SHARP	125
PCF8575TS/1.112	NXP	10
SI4401DY-E3	vishay	10
SN65HVD251D	TEXAS INSTRUMENTS	10
ST-080/B	NINIGI	10
ST-080/B	NINIGI	50
ST-082/B	NINIGI	70
ST-084/Y	NINIGI	50
UF4007	DC COMPONENTS	10
VAR10-275	SR PASSIVES	10
VS-K64WP-8	VISATON	4
ZL201-50G	NINIGI	2
8-215079-0	TE CONNECTIVITY	35
ZL201-50G	NINIGI	2
8-215079-0	TE CONNECTIVITY	35

4. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga dostawy części do 3 tygodni od daty zamówienia

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy;
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
- c) zaoferują fabrycznie nowe i wolne od wad części elektroniczne
 - spełniający minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt.6.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ, wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń (w przypadku dokumentów wymienionych w pkt.6b dopuszcza się przedstawienie kserokopii opatrzonej klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” potwierdzonych osobiście przez przedstawicieli wykonawców lub pełnomocników, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo uwzględniające zakres i okres obowiązywania – tożsame z przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne – powinno być dołączone do oferty):

- a) formularz ofertowy, złożony na druku, stanowiącym **załącznik nr 1** do SIWZ;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
- c) oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759);
- d) pełnomocnictwo/upoważnienie wskazujące zakres czynności upoważnionego (w przypadku, gdy dokumenty składa lub poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik),

Na podstawie art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone wraz z ofertą. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych w pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelka korespondencja dotycząca zamówienia publicznego, między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie pisemnie, mailem jowskiak@piap.pl kzp@piap.pl. W korespondencji należy powoływać się na znak postępowania KZP/21/2012.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego www.piap.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert do modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści jej treść na stronie internetowej.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający wyklucza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych upoważniony jest:
Stanisław Nycz tel. 22 87 40 314 w godzinach 9.00-14.00

W sprawach formalnych:

Joanna Gorzelniak – Owsiak tel. 22 87 40 233 w godzinach 8.30 - 13.30

8. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- a) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
- b) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- d) Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wypełniony druk oferty traktowany będzie jako jednoznaczne wyrażenie woli realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
- e) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością bez jej otwierania:
 - koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy;Oraz być oznaczona w następujący sposób:

**„Oferta - przetarg nieograniczony:” Dostawa części elektronicznych”
nie otwierać przed 04.04.2012”**

NR KZP/21/2011

Liczba stron (określić ile stron znajduje się w kopercie)

- f) Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.
- e) Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem), na druku ofertowym („Oferta”) dołączonym do SIWZ lub innej formie, ale przy dokładnym zachowaniu numeracji stosowanej w druku „Oferta”. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku Oferta. Druk Oferta stanowi załącznik numer 1 do SIWZ (w formie drukowanej i w formacie elektronicznym)
- h) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
- i) Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6.
- j) Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami winna być zszyta w całość, ponumerowana kolejnymi numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które nie muszą być ponumerowane) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę wraz z wszelkimi miejscami, w których Wykonawca naniósł zmiany.
- k) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- a) Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem określonymi w pkt 10 SIWZ – należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: **Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, bud. 6 pok. 13**

**ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OFERTY
ZŁOŻONE W INNYM MIEJSCU NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ ORAZ ZA
BŁĘDNE OZNAKOWANIE KOPERT**

- b) Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego określonego w pkt 11a **do godziny 11⁰⁰ dnia 04.04.2012r.**
- c) Za moment faktycznego złożenia oferty przyjmuje się fakt jej fizycznego złożenia za potwierdzeniem w siedzibie PIAP, Al. Jerozolimskie 202, budynek 6, pok.13 w Warszawie lub otrzymania przesyłki pocztowej przez Zamawiającego.
- d) Celem dokonania zmian bądź poprawek, Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert

- e) Oferty wycofane przez wykonawcę, będą mu zwrócone. po terminie otwarcia ofert. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne, względem ofert zamiennych, nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.
- f) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
- g) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się u zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, pok. 13 budynek 6
w dniu 04.04.2012 o godz.11³⁰

i przebiegać będzie zgodnie z art. 86 ustawy.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt asortymentu, wymienionego w pkt 3, koszt transportu (dostawy) i instalacji .

Zaoferowana cena musi być ceną brutto.

Cenę oferty należy przedstawić w Formularzu oferty (załączniku nr 1 do SIWZ).

Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

a. Kryteria oceny i ich ranga w ocenie

L	Kryterium	Ranga
p	Cena	100 %
.	RAZEM	100 %

b. Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących wzorów:

Kryterium – $K1 = 100 * \text{najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.}$

c. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z **najniższą ceną brutto**, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po upływie terminu nie krótszego niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, zostanie podpisana umowa z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Wykonanie umowy:

Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi (zgodnie z zapisami w Rozdz. 3 niniejszej SIWZ).

2. Warunki płatności:

Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat zaliczek.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać ceny jednostkowe dostarczonego sprzętu.

Płatności będą realizowane w PLN.

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. Kary umowne

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania zamówienia szczegółowego Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości tego zamówienia, za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

W razie niuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

W sprawach, które nie będą uregulowane umową zawartą pomiędzy stronami, zastosowane zostaną przepisy KODEKSU CYWILNEGO.

Wszystkie spory między stronami (wynikłe z wykonania umowy), których nie da się rozwiązać polubownie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy oraz zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór umowy po zapoznaniu się z nim, zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do składanej oferty jako załącznik.

4. Zmiany w umowie

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy i innym uczestnikom postępowania szczegółowo określone zostały w Dziale VI ustawy.

18. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych.

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Nie dotyczy.

21. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

22. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami,

Załącznik nr 2 - Wzór umowy,

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu dostawy

Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia

ZATWIERDZAM

Dr inż. Jan Jabłkowski